

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年12月10日-12日)

编号：2024-017

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、浙商证券、国元证券、高盛证券、五地基金
时间	2024年12月10日-12日
地点	线上会议 灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 第二部分：问答环节 1、问：公司2024年1-9月的经营业绩情况？ 答：公司2024年1-9月生产经营情况正常，主要财务数据及指标变动合理。 2024年1-9月，公司实现营业收入2.69亿元，较上年同期增长2.43%，实现归属于上市公司股东的净利润5,004.19万元，较上年同期增长68.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,109.74万元，较上年同期增长166.41%，主要系（1）对比的去年同期净利润基数较低；（2）公司持续开发新产品、拓展新市场，本期产品结构的变化带来盈利的能力有所提升；（3）较上年同期理财收益有所增加导致投资收益增加，以及本期存款利息增加导致财务费用减少；（4）股份支付费用同比减少，导致管理费用同比减少。 截至第三季度报告期末，公司财务状况良好，总资产25.03

亿元，较上年度末增长 6.48%，归属于上市公司股东的净资产 21.68 亿元，较上年度末增长 1.54%。

2024 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿元，较上年同期增长 387.56%，主要系（1）年初至报告期末因采购账期调整导致购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅下降；

（2）年初至报告期末销售商品收到的现金同比有所增加；（3）年初至报告期末支付各项税费、支付的职工薪酬等形成的经营活动现金流出同比有所下降。谢谢。

2、问：公司的产品有用到卫星上吗？

答：公司的产品有应用于星网计划，公司长期以来参与国防科工领域重点工程，公司将与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展。谢谢。

3、问：高端陶瓷器件的技术壁垒主要有哪些？

答：电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域，研发难度大，设计难度高，生产工艺复杂，属于典型的技术密集型产业。

① 材料壁垒

自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求，其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析，研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密，难以进行逆向工程和复制，行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。

② 工艺壁垒

电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累，需要在实践中不断摸索才能取得，如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩，产品的良率较低，导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段，从而保证生产的标准化、系列化，从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后，均会采用专利、商业秘密等手段加以保护，潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。

③ 创新研发壁垒

电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大，由于下游行业的快速发展，技术更新速度较快，对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求，上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力，将缺乏持续的研发创新能力，难以满足快速变化的市场需求，无法在市场上长期生存和发展。

综上所述，电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术，生产工艺也需要较长时间的积累，在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化，进入壁垒较高。谢谢。

4、问：公司 HTCC 产品的进展情况？

答：公司目前已建成完整的 HTCC 自动化设备产线，建立了 HTCC 产品线端到端的能力。从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在 HTCC 陶瓷材料领域，根据不同应用场景，公司已开发出 92/95/96/99 氧化铝等成熟配方 8 种，并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在 HTCC 制造工艺领域，公司已实现单层厚度最小 0.1mm，最小孔径 0.1mm，最小线宽 50um，最小线距 50um 的极限工艺能力，适用于高精度 HTCC 产品制造。在 HTCC 封装产品形态方面，公司已完成微波 SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP 等系列封装产品的开发和送样；其中微波 SIP 等产品已取得客户认可，开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域，公司数款 DPC 陶瓷基板已完成小批量交付验证。

公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜 MEMS 无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产，目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板，已经开始批量生产。

控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C 终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得了阶段性进展。谢谢。

5、问：公司的产品能用在 5.5G 基站上吗？

答：公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用 sub-6GHz 频段内的各应用场景，包括 4G、5G、5G-A/5.5G 等各类架构通信网络。公司将持续跟踪 5G-A/5.5G、6G 技术发展动态，做好相关的预研及技术储备，与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展，积极参与客户的解决方案。谢谢。

6、问：目前公司募投项目“新建灿勤科技园项目”进展情况如何？

答：公司募投项目“新建灿勤科技园”项目共包含三个子项目：介质波导滤波器产能扩张项目、新建 HTCC、LTCC 产品线项目、新建电子陶瓷研究院项目。一期工程部分厂房已于 2023 年底达到预定可使用状态；二期工程目前土建已完成超过 60%；三期工程目前已拿到施工许可证，正在打桩。谢谢。

7、问：公司未来具体的发展计划有哪些？

答：1、创建一流的电子陶瓷材料研发平台

电子陶瓷材料作为核心基础原材料，是实现各种电子元器件的基础，也是实现公司战略目标的关键。作为基础材料，电子陶瓷材料在介电特性、损耗特性、热力学特性等方面是电子元器件的发展核心，其重要性对电子元器件不言而喻。经过几十年的发展，各种新型电子陶瓷材料和新型应用层出不穷。随着 5G 建设大规模开展及万物互联时代的到来，各种新应用对电子设备的性能、能耗、可靠性、成本提出了越来越高的要求，也给电子陶瓷材料的发展和壮大提供了广阔的舞台。电子陶瓷材料的开发，将是材料学科的下一个蓝海。

在电子陶瓷材料领域，一方面，公司将在现有基础上不断完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用。另一方面，公司将依托现有的陶瓷材料研发体系及经验，拓展电子陶瓷材料应用的新领域，着力开发一批 HTCC 陶瓷、LTCC 陶瓷、高强度介质陶瓷、热管理陶瓷、储能陶瓷、复合陶瓷材料等先进陶瓷材料。在电子陶瓷先进工艺领域，公司将加大投入并着力打造面向未来的，全体系的电子陶瓷先进工艺技术平台，涵盖陶瓷材料制备、陶瓷体加工、陶瓷金属化及表面处理、陶瓷组装等工艺领域，为电子陶瓷的广泛应用打下坚实的基础。

2、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位

随着基站用陶瓷滤波器的市场需求不断增长，公司目前已成为国内外主要通信设备制造商的重要供应商。面对通信产业以介质滤波器为代表的各类陶瓷射频元件的市场需求，公司拟加大投入力度，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等。

在介质滤波器、介质谐振器、介质天线等射频器件方面，依托公司积累的设计制造经验和广泛的客户认可度，大力推广该类产品的市场应用，完善公司在移动通信市场的布局，成为射频元器件无源器件的综合供应商。

3、拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场

电子陶瓷作为功能陶瓷领域的一个重要分支，在现代通讯、半导体、电力电子、交通运输、航空航天等领域已有广泛应用，并形成了一批起源于日本、美国等的电子陶瓷头部企业。随着这些产业的半导体技术、新能源技术、AI 等核心技术的快速发展，电子陶瓷的应用领域将进一步拓宽，为人类社会发展作出更加巨大的贡献。公司将对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场，深度拓展电子陶瓷新应用。

在新能源、半导体、万物互联等领域，公司将依托先进电子陶瓷材料、全体系电子陶瓷加工工艺等平台，发挥积累多年的电

	子陶瓷元器件的设计制造经验，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本电子陶瓷产品，涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合陶瓷、LTCC 器件、介质陶瓷元器件等一系列产品及解决方案，以满足新能源、半导体、万物互联等产业的发展需求。谢谢。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 13 日